证券代码：300428　　证券简称：立中集团　　公告编号：2025-014 号

债券代码：123212　　债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式接待了机构调研，现将主要情况公告如下:

一、调研情况

1、调研时间：2025 年 3 月 6 日

2、调研形式：线上路演

3、参会人员：立中集团副总裁、董事会秘书李志国；立中集团证券事务代表冯禹淇。

4、调研机构：

序号	机构名称	姓名
1	中金公司	厍静兰
2	兴业证券	赵远喆
3	长江证券	易轰
4	中邮证券	李帅华
5	浙商证券	郑景毅
6	华创证券	李昊岚
7	德邦证券	康宇豪
8	民生证券	袁浩
9	华福证券	赵泽彬
10	华泰证券	马晓晨
11	中信证券	陈彦龙

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司 2024 年年度和第四季度的业绩情况如何？

答：2025 年 2 月 24 日，公司发布了 2024 年度业绩快报，公司营业收入和归

母净利润实现了双增长。2024 年公司在保持稳健经营的基础上，深入开拓市场与客户资源，公司主要产品产销量稳中有增，叠加铝价的同比增长，公司营业收入有效提升，全年累计实现营业收入 272.49 亿元，较上年同期增长 16.62%。其中第四季度公司各板块业务销量快速提升，营业收入达到了上市以来的单季度新高 78.79 亿元，环比增长 14.96%，实现连续三个季度环比正增长。

2024 年，公司全力推动高附加值产品的研发与市场开拓，优化管理流程，提升运营效能，落实降本增效策略，盈利能力持续提升。但报告期内由于部分新增工厂投产，产能爬坡给公司业绩带来阶段性承压；同时受海外政治经济因素影响，汇率波动导致的汇兑损失侵蚀了部分经营业绩。2024 年累计实现归属于上市公司股东的净利润为 6.91 亿元，较上年同期增长 14.08%，剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润为 7.40 亿元，较上年同期增长 4.29%。其中第四季度公司各业务板块核心业务稳定，高端、高附加值产品销量提升，带动盈利能力进一步增强，单季度剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润为 2.07 亿元，环比增长 71.2%。

2、公司在机器人领域有何布局？

答：公司深耕铝合金产业 40 年，拥有行业领先的材料研发水平和丰富的材料技术储备。公司持续关注在机器人领域的产业布局，铝合金作为机器人常用的轻量化材料，在机器人制造中发挥着优异的轻量化效果，公司现有的高强高屈服免热处理压铸铝合金、A356 铝合金、6 系和 7 系变形铝合金等产品可用于机器人零部件的制造。其中，公司的高强高屈服免热处理压铸铝合金正在某欧洲机器人关节转轴上进行材料验证。

3、公司研发的可钎焊压铸铝合金材料获得了 2024 年扶轮奖的汽车技术创新突破奖，请介绍一下这个材料的研发背景、优势和应用？

答：随着汽车市场的发展，热管理领域愈发被各汽车厂商重视，尤其是新能源汽车的电池热管理更是汽车安全运行的基石。新能源汽车热管理系统的流道板等液冷板基板，目前多采用热锻或机加工的方式生产，然后通过钎焊工艺与盖板进行焊接，这种加工方式流程长、成本高、效率低，市场对可以满足钎焊要求的，且铸造性能和力学性能良好的新型压铸铝合金材料需求持续增加。

公司研发的可钎焊压铸铝合金能够解决现有的可高温钎焊压铸铝合金成本偏高，导热率偏高而低导热场合无法适用的问题，且该产品在材料成本和铸造性能方

面具有较强的竞争优势。该材料可应用于汽车、储能和算力中心等领域热管理系统，公司目前正在积极对接汽车热管理系统流道板上的验证和应用。

4、公司的材料在航空航天和低空经济领域有何应用？

答：公司持续关注航空航天和低空经济领域的发展和前沿应用，目前公司研发和生产的航空航天级特种中间合金已成功间接用于制造飞机发动机排气塞、发动机扇叶、喷嘴构件、起落架、制动盘和紧固件等关键部位，同时也间接供货给国外某飞行汽车公司的电动飞机（“空中出租车”）；生产的铝基稀土中间合金已应用于大飞机和航天部件铝合金的制造；此外，公司研发的硅铝合金、铝基复合材料、微晶铝合金材料和 3D 打印铝合金材料等硅铝弥散复合新材料可用于航空航天电子封装、飞机部件、光学设备等；公司的高强高屈服免热处理压铸铝合金也正在国内某知名无人机品牌的无人机结构件上进行材料验证。

5、公司的材料在半导体领域是否可以应用，是否有相应布局？

答：公司研发的铝硅、铝碳化硅等合金新材料具有低膨胀、高导热、低偏析、高刚度等特点，可用于制造芯片外部的封装壳体，已在航空航天飞行器领域使用的电子系统和大功率集成电路封装中得到应用；同时该材料已应用于半导体设备的零部件制造，如基座、支撑架、静电卡盘等。

在业务布局方面，公司参与投资基金的已投项目保定中创燕园半导体科技有限公司是从事第三代半导体关键材料技术及应用的高新技术企业，主营业务为新型图形衬底、高散热 ALN 陶瓷基板、ALN 多晶复合衬底及第三代半导体功率器件等产品。该公司已量产产品新型图形衬底为国内具有完全自主产权的 PSS 衬底替代产品；并且联合北京大学开发的 ALN 多晶复合衬底有望大幅降低功率器件的成本。同时其自主研发的无苯流延技术制备的 AlN 陶瓷基板，在抗弯强度、热导率方面亦表现优异。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日